

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2024-039

成都旭光电子股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实际募集资金净额为534,504,090.90元。

上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	55,000.00
减：发行费用	1,549.59

募集资金净额	53,450.41
减：置换预先投入募集资金金额	12,806.19
减：以前年度使用金额	22,649.35
减：本报告期直接投入募投项目金额	3,265.03
加：利息收入及理财收益减除手续费	691.16
募集资金余额	15,421.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都旭光电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构华西证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都新都支行、成都银行股份有限公司郫都支行、中信银行股份有限公司成都分行和广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	账户余额
------	------	------	------

开户主体	开户银行	银行账号	账户余额
成都旭光电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都马超西路支行	4402943029100134835	44,863.48
成都旭光电子股份有限公司	成都银行犀浦支行	1001300001054898	30,236,024.05
成都旭光电子股份有限公司	中信银行成都银河王朝支行	8111001012800854425	123,920,309.80
宁夏北瓷新材料科技有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	801101001316867745	8,839.37
合计			154,210,036.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，本次募集资金到位前，公司及实施募投项目的子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司（以下简称“北瓷新材料”）根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。自2022年1月21日至2022年9月23日止，公司及北瓷新材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币12,806.19万元。截至2022年9月23日公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币148.34万元。预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计12,954.52万元。

公司于2022年9月28日召开的公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计12,954.52万元，上述事项已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（川华信验（2022）第0631号）。

本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年9月22日召开的公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议及2023年10月13日召开的《2023年第一次临时股东大会》通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为139.28万元，尚未到期的理财金额为0.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	批准使用金额	实际使用金额	期限	期末投资份额	报告期收益情况	募集资金是否如期归还
中信银行成都分行	结构性存款	20,000	12,200.00	2023年10月21日 - 2024年1月21日		79.72	到期归还
			12,200.00	2024年1月29日 - 2024年4月30日		32.29	到期归还
			12,200.00	2024年5月13日 - 2024年6月14日		27.27	到期归还

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也不存在对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				53,450.41			本年度投入募集资金总额			3,265.03		
变更用途的募集资金总额				无			已累计投入募集资金总额			38,720.57		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子封装陶瓷材料扩产项目	否	13,670.86	13,670.86	13,670.86	-	13,680.72	9.86	100.07	2024年			否
电子陶瓷材料产业化项目(一期)	否	31,979.55	31,979.55	31,979.55	3,265.03	17,239.85	-14,739.70	53.91	2024年			否
补充流动资金	否	7,800.00	7,800.00	7,800.00	-	7,800.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	53,450.41	53,450.41	53,450.41	3,265.03	38,720.57	-14,729.84	72.44	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				电子封装陶瓷材料扩产项目主体工程已基本竣工, 为了进一步提升产能和产品良率, 生产设备的优化调试仍持续推进中。为保障募投项目质量, 维护公司及全体股东利益, 结合当前募投项目实施进度, 经过综合分析和审慎评估, 公司董事会决定将“电子封装陶瓷材料扩产项目”达到预定可使用状态的预计时间由2023年12月延期至2024年12月。								

	<p>电子陶瓷材料产业化项目（一期）募投项目建设工作已取得阶段性进展，其中氮化铝基板及结构件产品已达成部分关键指标，但由于国内半导体市场的逐步升级，对相关产品的质量和性能也提出更高的要求，同时，HTCC 及氮化硅基板涉及的制造工艺复杂，并且生产验证周期较长。为确保产品质量与性能稳定，更好的服务于客户，后续仍需更多时间进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作，经公司充分考虑和审慎研究，公司决定将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的预计时间由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月。此外，受外部经济环境和市场需求波动的影响，公司主动调整了设备预投时间规划。</p> <p>上述延期事项已经公司第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第二十次会议审议通过。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见报告正文三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见报告正文三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：电子封装陶瓷材料扩产项目承诺投资金额 13,670.86 已全部使用完毕，上表中实际累计超支部分 9.86 万元为该项目募投资金产生的利息。已累计投入募集资金总额 38,720.57 万元中，包括募集资金 38,710.71 万元及其部分利息收入 9.86 万元。